

SMT 266塗層黏合劑產品資料表

增強焊点可靠性

消除焊点破裂

免除底部填充胶

简介

SMT 266 系列噴塗膠合劑旨在提高焊點可靠性，並消除 CSP、BGA、倒裝晶片和 PoP(封裝堆疊)裝置的焊點開裂問題，尤其適用於無鉛焊接應用。SMT 266 是一種聚合物溶液，噴塗到印刷電路板或基板的元件焊盤上後會形成一層聚合物薄膜。在回流焊過程中，聚合物薄膜會去除金屬氧化物，使焊點得以形成;同時，三維聚合物網絡開始形成並包裹單個焊點，從而增強焊點強度，消除底部填充的一些缺點(例如高於玻璃化轉變溫度 (Tg) 的高熱膨脹係數、製程控制困難等)。與使用焊膏相比，其跌落測試性能提高了兩個數量級。

物理特性

产品名称	SMT 266 涂覆型胶水
外观	无色或淡黄色液体
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	0.9-1.0
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	6-10 cp
定量卤化物含量	0%
固化材料特性	
拉伸強度 (MPa)	56
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	23.5

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

應用

本產品可透過手動噴塗或自動噴塗系統塗覆到印刷電路板或基板的元件焊盤上。為獲得最佳性能，建議SMT 266的濕膜厚度為 2 ± 0.5 mil。但是，仍需根據焊盤高度和元件尺寸調整濕膠的厚度。印刷焊膏用於其他SMT元件

-> 噴塗SMT266用於CSP/BGA -> 貼裝SMT元件 -> 回流焊接，膠合劑固化

回流焊接和固化

SMT 266 與目前的 SMT 組裝流程以及所有類型的焊盤表面處理（例如 Ni/Au、浸銀、OSP）完全相容。它可在空氣或氮氣環境下，用於對流、傳導、紅外線或氣相焊接系統。從室溫到峰值溫度的時間應為 4 至 5 分鐘，峰值溫度為 230°C 至 260°C。

儲存和保存期限

如果材料保存在密封的原容器中，溫度為 -10°C 至 0°C，則保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防止受潮、蒸發和外來物污染。蒸發和污染會影響這些產品的加工性能。

安全

SMT 266 是一種環保無毒材料。但是，建議在處理此材料時遵循一般的衛生操作規範。更多詳細信息，請參閱我們的安全資料表 (SDS)。

包裝

SMT 266 系列噴膠提供 2 oz, 8 oz 包裝。其他包裝可依客戶要求提供。請聯絡 YINCAE 以取得訂購資訊。